

证券代码：002916

证券简称：深南电路

深南电路股份有限公司投资者关系活动记录表

编号：2025-28

投资者关系 活动类别	√ 特定对象调研 □ 分析师会议 □ 现场参观 □ 媒体采访 □ 业绩说明会 □ 新闻发布会 □ 路演活动 □ 其他（_____）
活动参与人员 （排名不分先后）	易方达基金、交银施罗德、财通证券、国寿养老保险、富国基金、国投证券、中泰证券、Millennium
上市公司 接待人员	副总经理、董事会秘书：张丽君；战略发展部总监、证券事务代表：谢丹；
时间	2025 年 8 月 28 日-29 日
地点	网络及电话会议、公司会议室
形式	网络及电话会议、实地调研
投资者关系 活动主要内容介绍	交流主要内容： Q1、请介绍公司 2025 年半年度经营业绩情况。 公司把握 AI 算力升级、存储市场回暖和汽车电动智能化趋势深化的发展机遇。2025 年上半年，公司实现营业总收入 104.53 亿元，同比增长 29.21%，归母净利润 13.60 亿元，同比增长 37.75%。 其中，PCB 受益于 AI 加速卡、服务器等产品需求的释放，高速交换机、光模块需求的显著增加，以及汽车电子和 ADAS 的增长。PCB 业务实现主营业务收入 62.74 亿元，同比增长 29.21%，业务毛利率 34.42%，同比增加 3.05 个百分点；封装基板业务主要受益于国内存储市场需求的回暖，公司在持续聚焦能力建设的同时，加速推进市场开发，推动订单收入增收。封装基板业务实现主营业务收入 17.40 亿元，同比增长 9.03%，业务毛利率 15.15%，同比减少 10.31 个百分点；电子装联业务把握数据中心及汽车电子领域的需求增长机会，推动营收增长。电子装联业务实现主营业务收入 14.78 亿元，同比增长 22.06%，毛利率 14.98%，同比增长 0.34 个百分点。

Q2、请介绍公司 2025 年上半年 PCB 业务产品下游应用经营情况。

公司在 PCB 业务方面从事中高端 PCB 产品的设计、研发及制造等相关工作，产品下游应用以通信设备为核心，重点布局数据中心（含服务器）、汽车电子等领域，并长期深耕工控、医疗等领域。

2025 年上半年，通信、数据中心、汽车电子等领域对 PCB 业务营收增长均有贡献。其中，通信、数据中心在算力需求的拉动下，400G 及以上的高速交换机、光模块需求显著增长，AI 加速卡、服务器等及相关配套产品的需求提升，营收增长明显。在汽车领域，公司继续把握汽车电子和 ADAS 方向的增长机会，实现了订单收入的增加。PCB 业务毛利率的增长主要得益于营收规模增加，PCB 工厂产能利用率进一步提升，AI 相关领域订单需求增长助益 PCB 业务产品结构优化。

Q3、请介绍公司 2025 年上半年封装基板业务在下游市场经营情况。

封装基板作为一种高端的 PCB，具有高密度、高精度、高性能、小型化及薄型化等特点，是芯片封装不可或缺的一部分。公司生产的封装基板包括模组类封装基板、存储类封装基板、应用处理器芯片封装基板等，主要应用于移动智能终端、服务器/存储等领域。

2025 年上半年，公司封装基板业务持续聚焦能力建设与市场开发，牢牢把握国内存储市场增长的机遇，加大市场拓展力度，推动订单显著增长。同时，FC-CSP 类工艺实现了技术能力的提升，市场竞争力增强，业务规模进一步扩大。RF 射频类产品新客户新产品的导入稳步推进，ABF 类封装基板各阶产品对应的产线验证导入、送样认证等工作有序推进中。

Q4、请介绍公司 FC-BGA 封装基板产品技术能力及广州封装基板项目爬坡进展。

公司已具备 20 层及以下 FC-BGA 封装基板产品批量生产能力，22~26 层产品的技术研发及打样工作按期推进中。公司广州封装基板项目一期已于 2023 年第四季度连线，产品线能力持续提升，产能爬坡稳步推进，已承接 BT 类及部分 FC-BGA 产品的批量订单。2025 年上半年广州广芯亏损环比有所收窄。

Q5、请介绍公司对电子装联业务的定位及布局策略。

公司电子装联业务属于 PCB 制造业务的下游环节，业务主要聚焦通信及数据中心、医

疗、汽车电子等领域。目前公司已具备为客户提供包括产品设计、开发、生产、装配、系统技术支持等全方位服务的能力。

公司发展电子装联业务旨在以互联为核心，协同 PCB 业务，发挥公司电子互联产品技术平台优势，通过一站式解决方案平台，为客户提供持续增值服务，增强客户粘性，电子装联业务多年来始终保持稳定发展。

Q6、请介绍公司近期产能利用率情况。

公司 PCB 业务因目前算力及汽车电子市场需求持续提升，工厂综合产能利用率处于相对高位；封装基板业务受国内存储市场的需求明显提升，工厂综合产能利用率同比明显改善。

Q7、请介绍公司 PCB 业务近年来扩产规划。

公司 PCB 业务在深圳、无锡、南通及泰国均设有工厂。公司对 PCB 业务扩产的规划包括两个方面，一是公司通过对现有成熟 PCB 工厂进行技术改造和升级，打开瓶颈，提升产能；二是公司有序推进南通四期项目及泰国工厂的建设，进一步释放 PCB 业务产能。公司将关注市场需求并结合自身经营规划，合理配置业务产能。

Q8、请介绍公司泰国项目规划及当前建设进展。

公司为进一步拓展海外市场，满足国际客户需求，在泰国投资建设工厂，总投资额为 12.74 亿元人民币/等值外币，目前已连线试生产。泰国工厂将具备高多层、HDI 等 PCB 工艺技术能力。

Q9、请介绍公司 2025 上年度研发投入情况。

公司长期坚持技术领先战略，高度重视技术与产品的研发工作，持续加大研发投入规模。2025 年上半年公司研发投入金额约 6.72 亿元，占公司营收比重为 6.43%。

目前公司各项研发项目进展顺利。公司继续稳步推进下一代通信、数据中心及汽车电子相关 PCB 技术研发，FC-BGA 基板产品能力建设，FC-CSP 精细线路基板和射频基板技术能力提升等项目。

Q10、请介绍上游原材料价格变化情况及对公司的影响。

	公司主要原材料包括覆铜板、半固化片、铜箔、金盐、油墨等，涉及品类较多。就公司成本端而言，2025 年上半年原材料价格整体有所上涨，主要受大宗商品价格变化的影响，贵金属及部分辅材价格有所上升，对公司利润产生了一定影响。公司将持续关注国际市场大宗商品价格变化以及上游原材料价格传导情况，并与供应商及客户保持积极沟通。
关于本次活动是否涉及应披露重大信息的说明	调研过程中公司严格遵照《信息披露管理制度》等规定，未出现未公开重大信息泄露等情况。
附件清单	无